

2016年3月期 決算説明会

5/11/2016



目 次

1. 本日の説明会のポイント.....	02
2. 2016年3月期決算の概要.....	03
3. 2017年3月期業績予想の概要.....	12
4. 株主還元.....	18
5. 中期経営計画 事業戦略と重点施策.....	20
6. 参考情報.....	30

本日の説明会のポイント

■2016年3月期業績

売上高 7期連続増収

利益 減 益

- 通信モジュール・自動車向け半導体、医用機器の増加
- デバイス事業における利益率の低下

■2017年3月期業績見通し

売上高 増 収

利益 前期並み

- 産業機器・自動車向け半導体の増加
- 利益率の改善、販売費及び一般管理費の増加

■中期経営計画

Think & Actionは着実に成果
新中計でROE経営を推進

2016年3月期決算の概要

2016年3月期 連結決算サマリ（対前期比）

■売上高は、58億円増（+2.2%）の2,795億円

- デバイス事業 通信モジュール・自動車向けの増加、PC・TV・ゲーム機向けの減少
- システム事業 医用機器、レーザ機器の増加

■営業利益は、13億円減（△29.4%）の32億円

- 売上総利益 デバイス事業における利益率低下による減少
- 販売費及び一般管理費 子会社の増加等による増加

■経常利益は、5.6億円減（△14.5%）の33億円

- 営業外費用 為替差損の減少

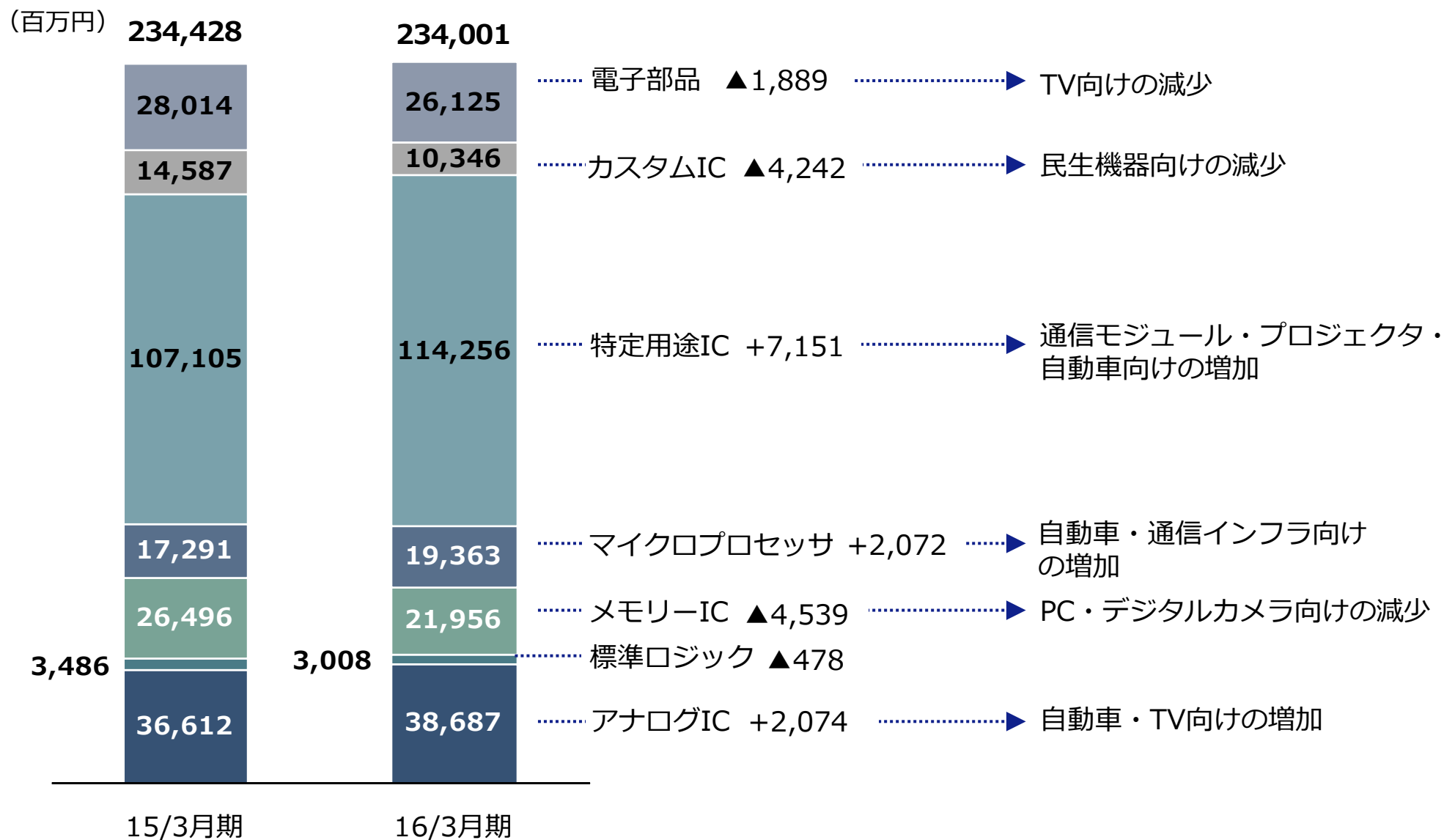
■当期純利益は、1.8億円減（△9.1%）の18.1億円

- 特別利益 投資不動産売却益(5.6億円)、投資有価証券売却益(1.9億円)
- 特別損失 保有不動産に関わる減損損失(8.3億円)

2016年3月期 業績サマリ

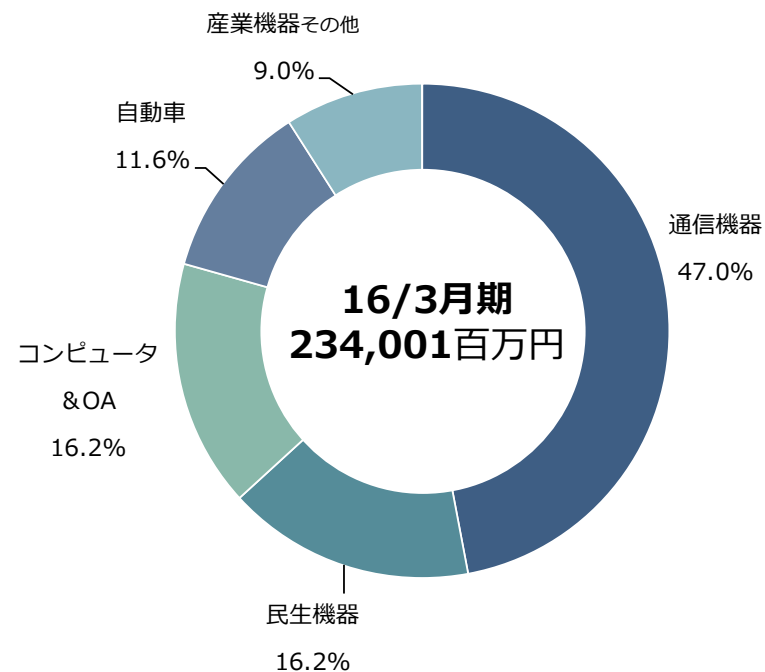
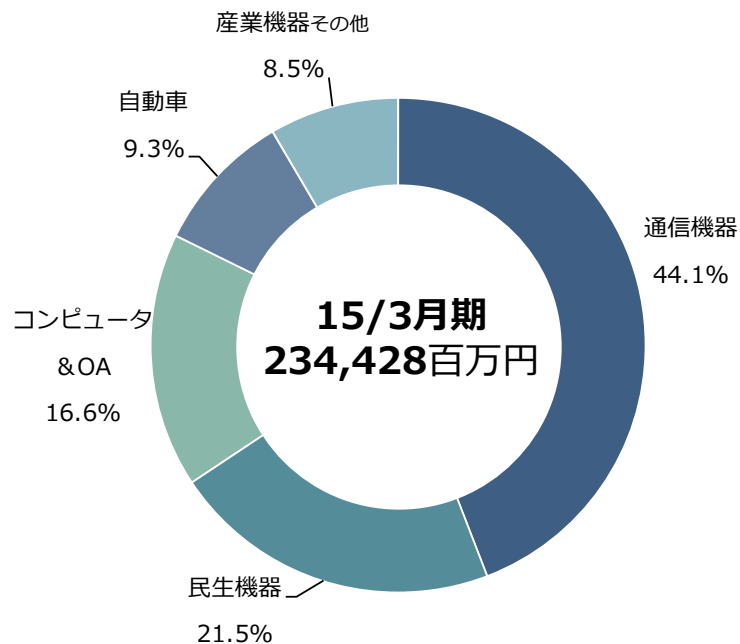
(百万円)	15/3月期		16/3月期		対前期比		16/3月期 業績予想	
	実績	構成比	実績	構成比	金額	%	15/10月予想	構成比
売上高	273,683	100.0%	279,571	100.0%	5,888	2.2%	284,000	100.0%
デバイス事業	234,428	85.7%	234,001	83.7%	△ 427	-0.2%	237,000	83.5%
システム事業	39,254	14.3%	45,570	16.3%	6,316	16.1%	47,000	16.5%
売上総利益	19,146	7.0%	18,319	6.6%	△ 826	-4.3%	20,000	7.0%
販売管理費	14,593	5.3%	15,106	5.4%	513	3.5%	15,450	5.4%
人件費	9,051	3.3%	9,264	3.3%	213	2.4%	-	-
その他	5,542	2.0%	5,842	2.1%	300	5.4%	-	-
営業利益	4,552	1.7%	3,212	1.2%	△ 1,339	-29.4%	4,550	1.6%
営業外収益	751	0.3%	734	0.3%	△ 17	-2.3%	600	0.2%
営業外費用	1,418	0.5%	624	0.2%	△ 793	-55.9%	650	0.2%
経常利益	3,886	1.4%	3,321	1.2%	△ 564	-14.5%	4,500	1.6%
特別利益	7	0.0%	870	0.3%	862	11176.0%	700	0.2%
特別損失	110	0.0%	893	0.3%	782	707%	750	0.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,990	0.7%	1,810	0.7%	△ 180	-9.1%	2,550	0.9%
期末従業員数（名）	1,235	-	1,266	-	31	2.5%	-	-

2016年3月期 デバイス事業品目別売上高



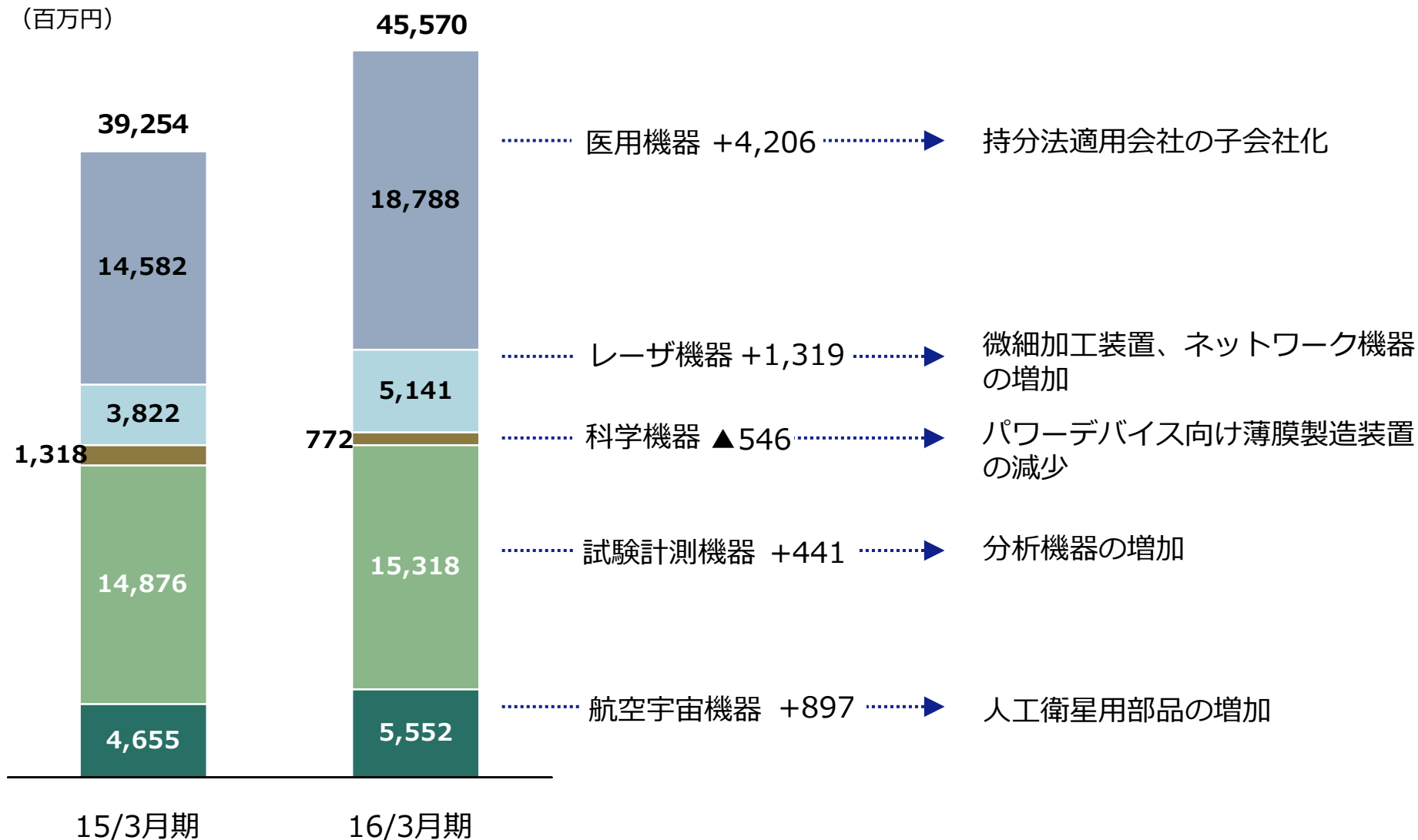
2016年3月期 デバイス事業 用途別市場動向

用 途	市 場 動 向
通信機器	通信モジュールや通信基地局向けが増加
民生機器	ゲーム機・デジタルカメラ向けが減少
コンピュータ&OA	PC向けが減少
自動車	ナビゲーション・車内通信・エンジンコントロール向けが増加
産業機器その他	FA機器向けが増加

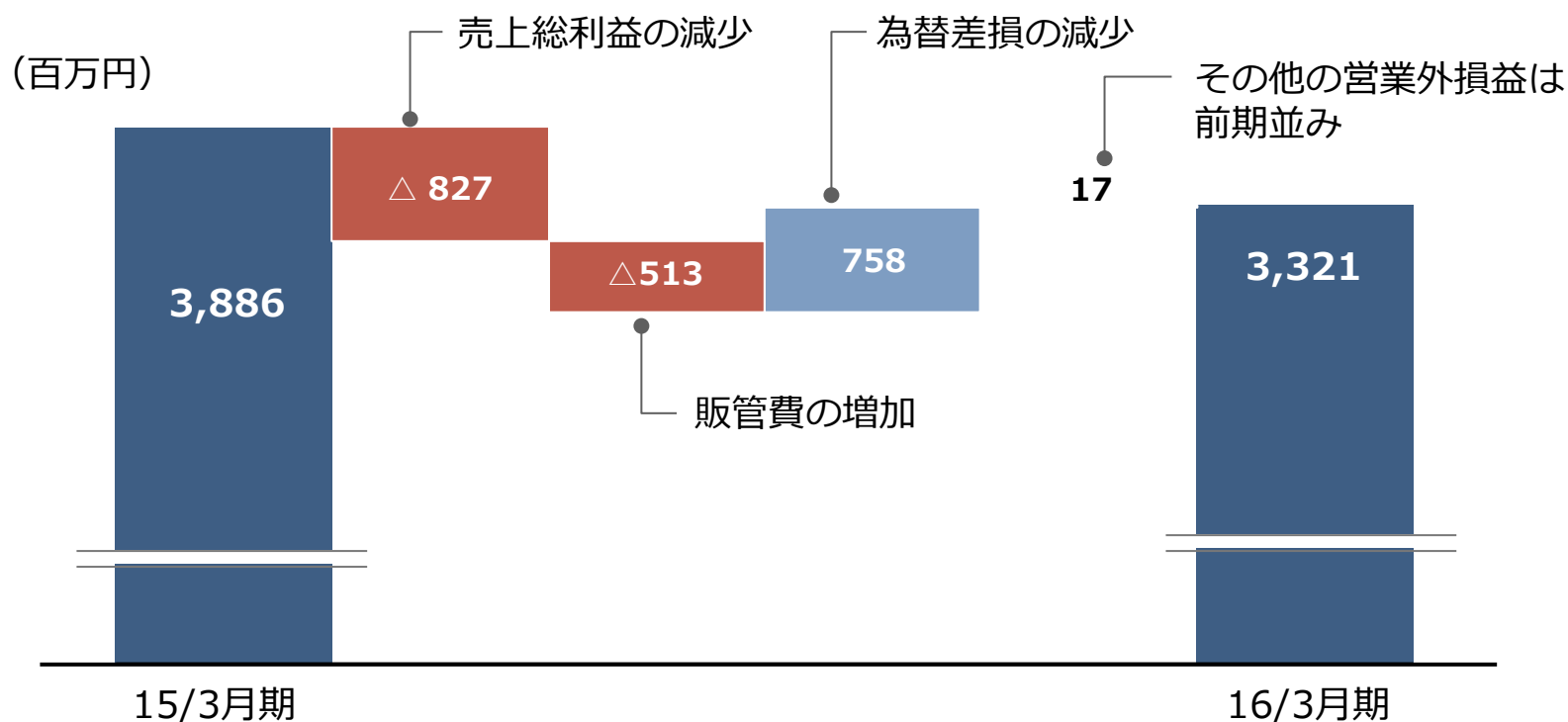


2016年3月期 システム事業品目別売上高

(百万円)



2016年3月期 経常利益の増減要因



売上総利益	競争激化や円高の進行による利益率低下による減少 15/3月期：191億円（7.0%） → 16/3月期：183億円（6.6%）
販管費	給与・賞与の増額や持分法適用会社の子会社化による人件費の増加、売上増加に伴う販売経費の増加
営業外損益	為替差損の減少 15/3月期：9億円 → 16/3月期：1.4億円

2016年3月期 貸借対照表の概要

(百万円)	15/3月期末 実績	16/3月期末 実績	対前期末比 増減額
流動資産	117,084	96,211	△ 20,873
現金及び預金	21,725	14,096	△ 7,629
受取手形及び売掛金	63,393	53,539	△ 9,854
商品および製品	28,818	24,765	△ 4,053
その他	3,147	3,809	662
固定資産	11,228	10,302	△ 926
有形固定資産	4,232	3,079	△ 1,153
無形固定資産	448	342	△ 106
投資その他資産	6,548	6,880	332
資産合計	128,313	106,513	△ 21,800
流動負債	72,594	49,481	△ 23,113
支払手形及び買掛金	52,978	35,921	△ 17,057
短期借入金等	15,300	9,732	△ 5,568
その他	4,316	3,827	△ 489
固定負債	9,416	10,693	1,277
長期借入金等	7,507	8,500	993
退職給付に係る負債	1,194	1,718	524
その他	714	475	△ 239
負債合計	82,010	60,175	△ 21,835
株主資本	38,068	39,255	1,187
その他の包括利益累計額	2,382	1,135	△ 1,247
非支配株主持分	5,851	5,977	126
純資産合計	46,302	46,338	36
負債純資産合計	128,313	106,513	△ 21,800

短期借入金の返済等による減少

投資不動産の売却等による減少

半導体需要減による減少

2016年3月期 キャッシュフロー計算書の概要

(百万円)	15/3月期 実績	16/3月期 実績	
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,202	△ 1,204	
税引前当期純利益	3,783	3,299	
売上債権の増減額（△は増加）	△ 1,168	10,647	半導体需要減による減少
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 11,639	4,067	
仕入債務の増減額（△は減少）	12,418	△ 17,811	
その他	△ 1,189	△ 1,406	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235	493	投資不動産等の売却、ベンチャー出資
フリー・キャッシュ・フロー	1,967	△ 711	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,515	△ 6,724	短期借入金の純減 58億円
現金及び現金同等物の増減額	2,536	△ 7,810	
現金及び現金同等物の期末残高	21,512	13,702	

2017年3月期 業績予想の概要

2017年3月期 業績予想サマリ

■売上高は、2,900億円（+104億円）の見込み

- デバイス事業 通信モジュール向け半導体の減少、ケイティーエル子会社化による増加
- システム事業 電子部品検査装置・パワー半導体製造用薄膜装置の増加

■営業利益は、32.5億円（前期並）の見込み

- 売上総利益 新規商材など高利益率製品の増加、ケイティーエル子会社化による増加
- 販売費及び一般管理費 子会社増加、退職給付費用の負担増による増加

■経常利益は、32.5億円（前期並）の見込み

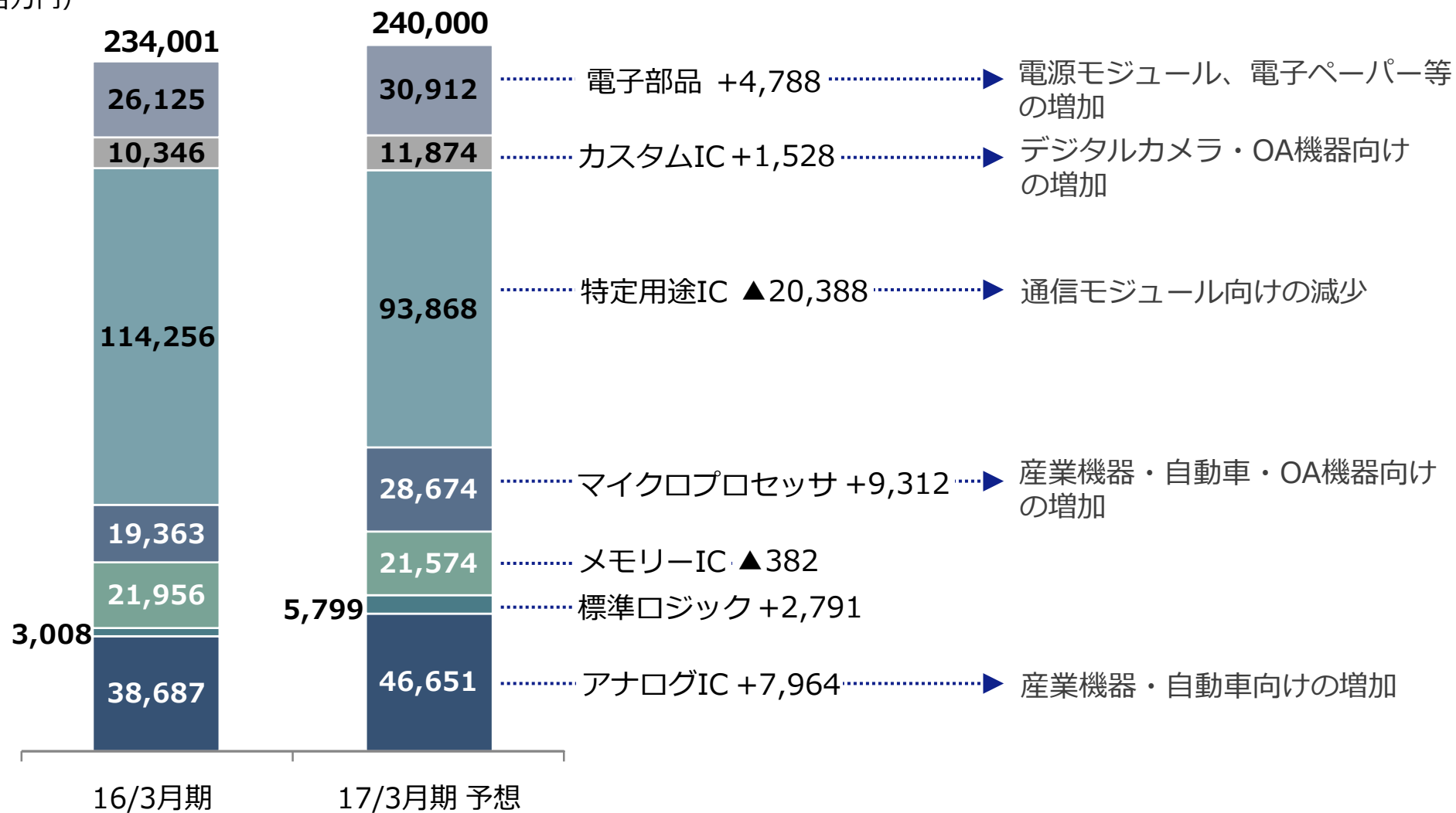
■当期純利益は、17.5億円（前期並）の見込み

2017年3月期 業績予想

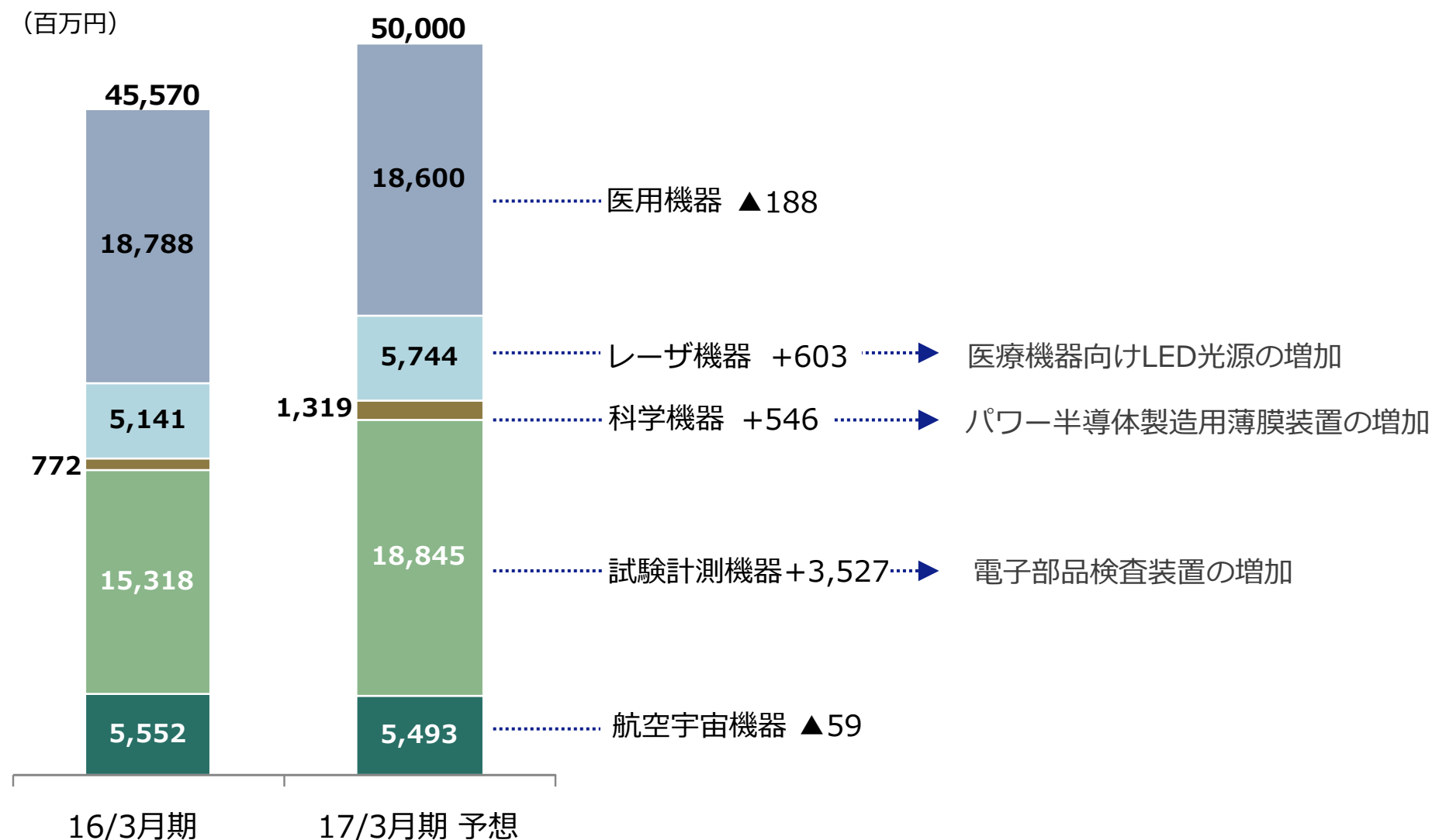
(百万円)	16/3月期		17/3月期		前期比	
	実績	構成比	予想	構成比	増減額	%
売上高	279,571	100.0%	290,000	100.0%	10,429	3.7%
デバイス事業	234,001	83.7%	240,000	82.8%	5,999	2.6%
システム事業	45,570	16.3%	50,000	17.2%	4,430	9.7%
売上総利益	18,319	6.6%	21,800	7.5%	3,481	19.0%
販売管理費	15,106	5.4%	18,550	6.4%	3,444	22.8%
営業利益	3,212	1.1%	3,250	1.1%	38	1.2%
営業外収益	734	0.3%	600	0.2%	△ 134	-18.3%
営業外費用	624	0.2%	600	0.2%	△ 24	-3.8%
経常利益	3,321	1.2%	3,250	1.1%	△ 71	-2.2%
特別利益	870	0.3%	0	0.0%	△ 870	-
特別損失	893	0.3%	0	0.0%	△ 893	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,810	0.6%	1,750	0.6%	△ 60	-3.3%

2017年3月期 デバイス事業品目別売上高予想

(百万円)

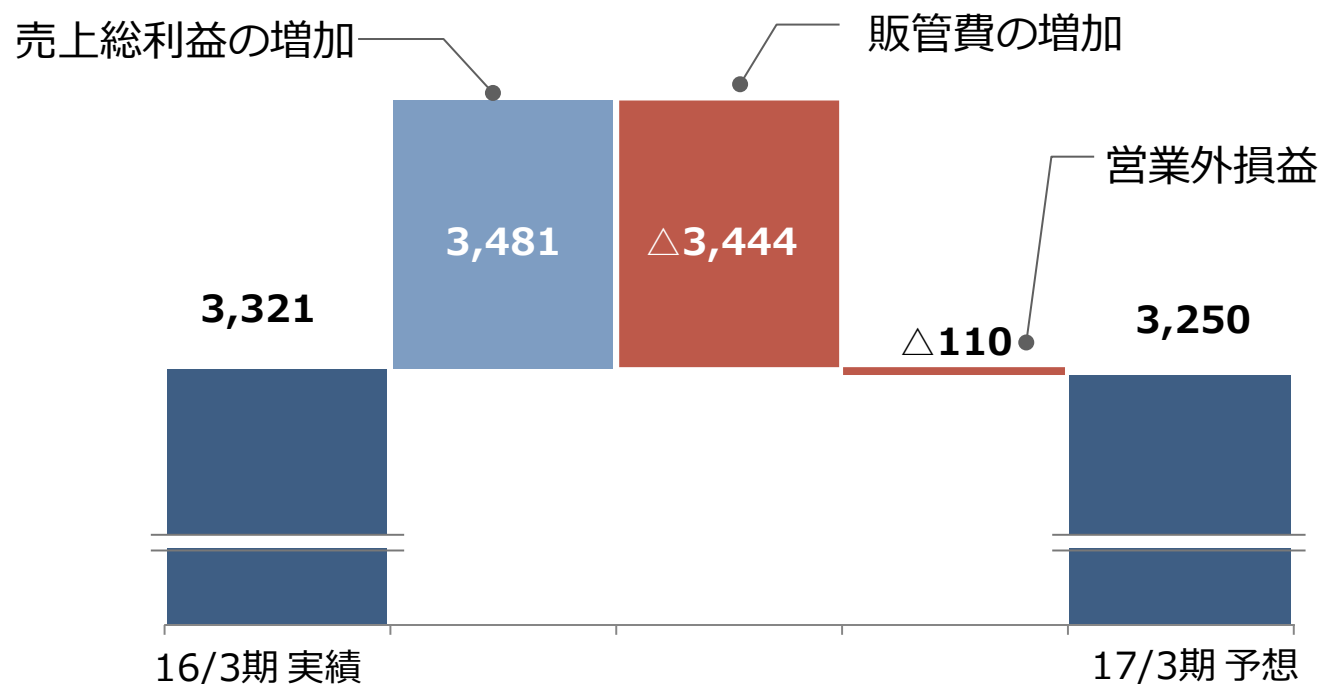


2017年3月期 システム事業品目別売上高予想



経常利益の増減要因（前期 vs. 予想）

（百万円）



売上総利益	高利益率製品の伸長による増加、子会社の増加 16/3月期：183億円(6.6%) → 17/3月期予想：218億円(7.5%)
販管費	子会社の増加、退職給付費用の増加 16/3月期：151億円 → 17/3月期予想：185億円
営業外損益	前期並み

株主還元

株主還元

■ 配当方針

配当性向	連結 30% 以上
------	-----------

■ 配当予想

(円)	2015年3月期	2016年3月期	2017年3月期 (予想)
1株当たり年間配当金	20.00	30.00	25.00
中間配当	7.00	12.00	10.00
期末配当	13.00	18.00	15.00

中期経営計画 事業戦略と重点施策

経営環境と事業の見通し

半導体メーカー

- M&Aの拡大
- 代理店政策の変更

国内電子機器メーカー

- 競争力低下
- 事業再編の加速

エレクトロニクス商社

- 商権流動化
- 経営統合

2014～2016年度中期経営計画

	2017/3月期 目標	2017/3月期 見通し	差 異
売上高	2,800億円	2,900億円	+ 100億円
経常利益	60億円	32.5億円	△27.5億円

持続的な成長が図れる
筋肉質な企業の実現



■ 中期定量目標（19/3月期）

ROE	8.0%以上
売上高	3,000億円
経常利益	65億円

新中期経営計画 セグメント別の重点施策

デバイス事業

- ① ベースビジネスの強化
- ② 新規商材の早期事業化
- ③ 成長市場での対応強化
- ④ グローバル展開の加速

システム事業

- ① エンジニアリングサービス拡充
- ② システムインテグレーション強化
- ③ 商品ラインナップ増強

ベースビジネスの強化

■ デザインイン機能の強化

カンパニー制の導入

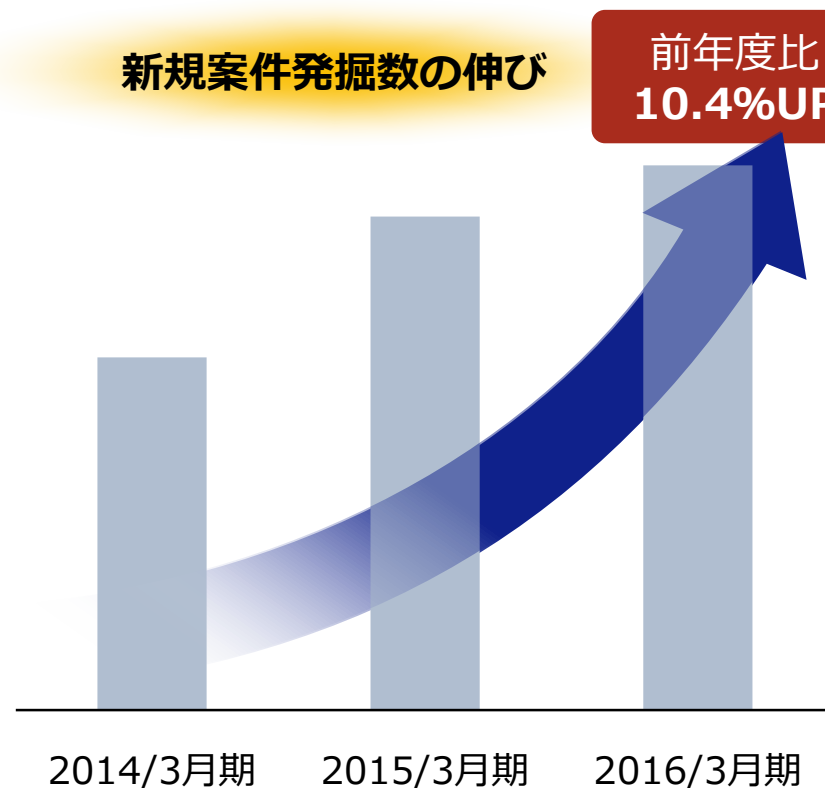
■ ソリューション提案力の強化

より上位のサービスを強化



新規案件発掘数の伸び

前年度比
10.4%UP



新規商材の早期事業化

- ▶ 新しくてユニークな技術の開発
- ▶ 新規商材事業化の専門組織の新設
- ▶ 資金や人材の投入で、サプライヤを育成

■ 米国を中心に50社以上の最新技術、最新製品をソリューション展開



FINsix社
超小型ACアダプター



mc10社
バイオスタンプ



成長市場での対応強化

■ 自動車、産業機器、医療、IoT分野
に注力

■ ケイティーエルの子会社化

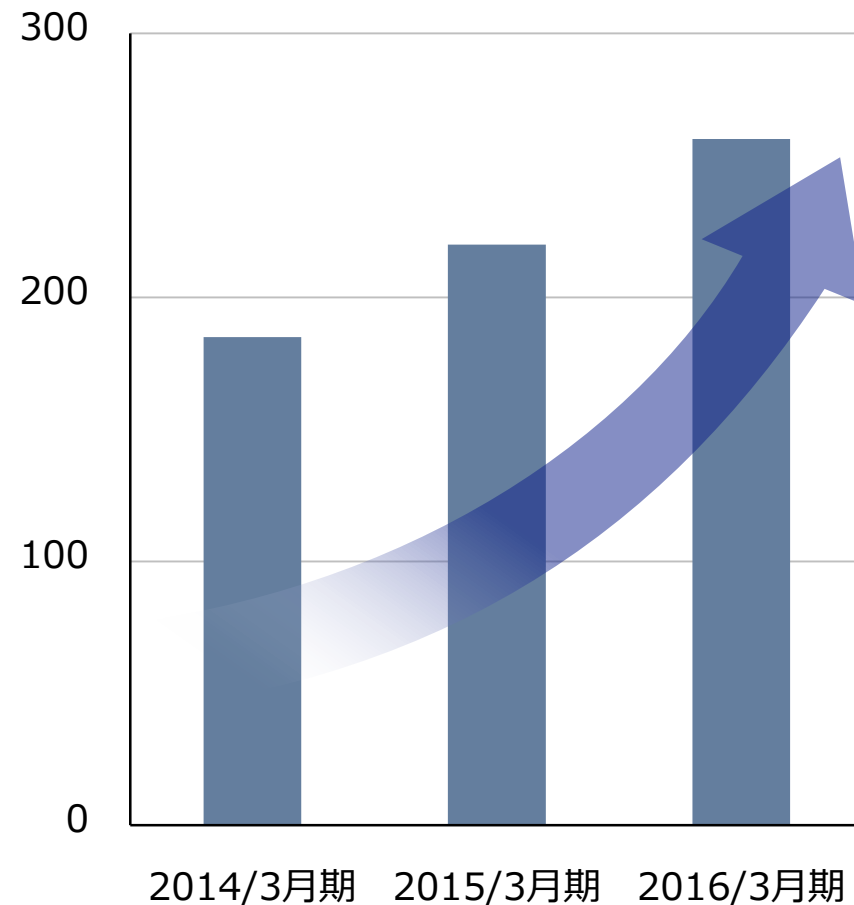
■ 自動車、産業機器の顧客基盤強化



IoT向けのオリジナルセンサ
ソリューション評価ボード

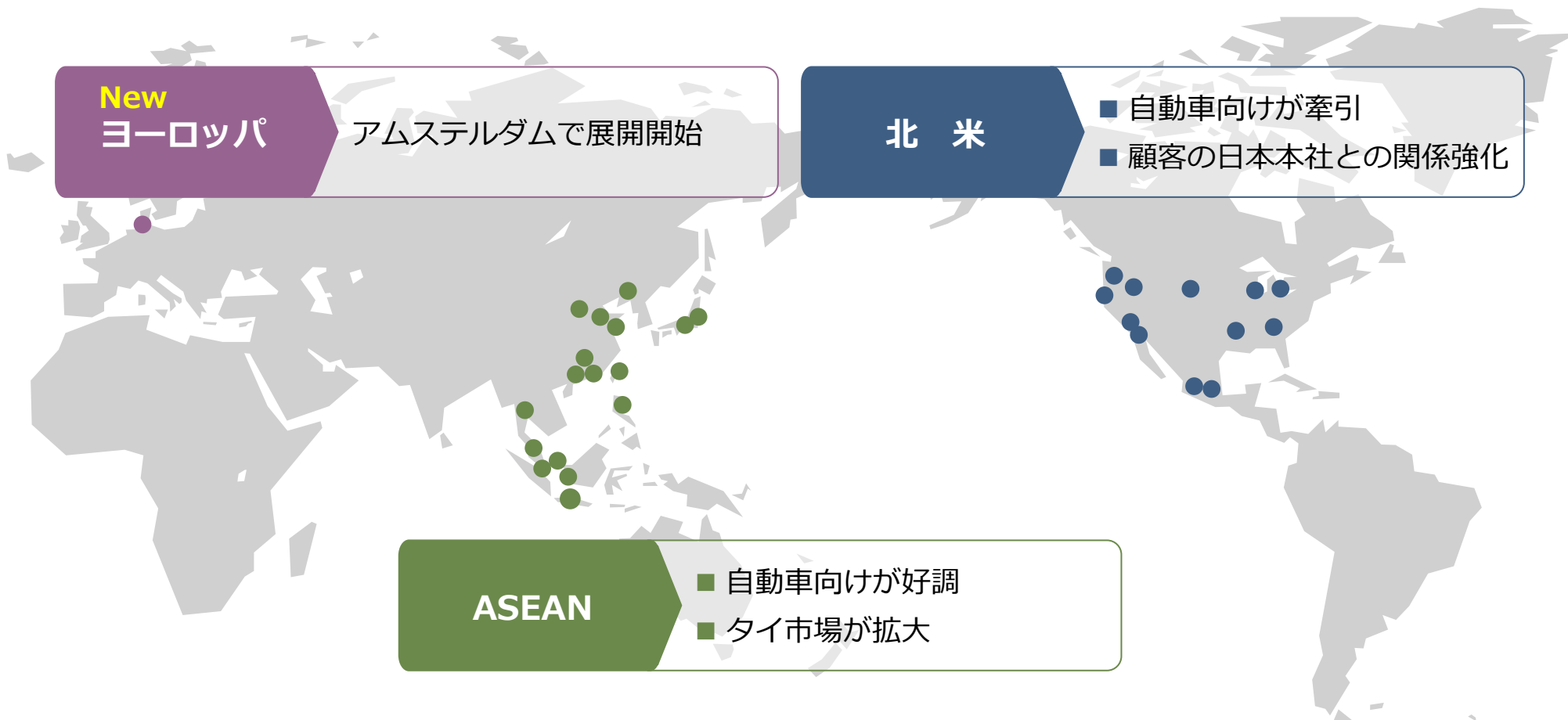
自動車分野向け売上高の推移

(億円)



グローバル展開の加速

■ アローエレクトロニクス社の幅広いサプライヤ・拠点網を活用



システム事業 重点施策

「マーケットイン」
と
「カスタマーイン」
の発想

顧客ごとに違うニーズに対応できるサービスと
ソリューションの提供による差別化の推進

①

エンジニアリング
サービス拡充

②

システム
インテグレーション
強化

③

商品ラインナップ
増強

システム事業 製品分野の取組み

産業機器

- 最新テクノロジー製品の提案
 - 深紫外LED製造装置・大気圧プラズマ発生装置

レーザー機器

- 産業機器向け半導体レーザーの水平展開
- 医療機器向けにLEDの品揃え拡充
- 東京オリンピックに向けたインフラ市場に注力

医用機器

- 保守・メンテナンスなどエンジニアリング強化
- サービスエリア拡大で収益向上、リピート獲得

参考情報

企業概況

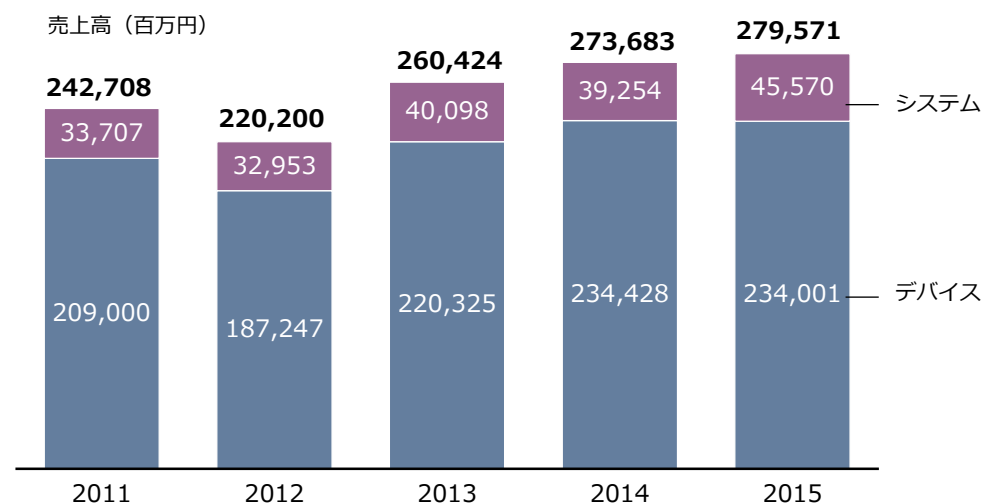
会社概要

創 業	1844年（弘化元年）
設 立	1947年（昭和22年）7月
所 在 地	東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
資 本 金	62億1,450万円
決算期日	3月31日
代 表 者	代表取締役社長 水野象司
売 上 高	連結 2,795億円（2016年3月期） 単体 1,777億円（2016年3月期）
従業員数	連結 1,266名（2016年3月末） 単体 678名（2016年3月末）
株式上場	東京証券取引所 市場第一部（コード:7537）

事業領域

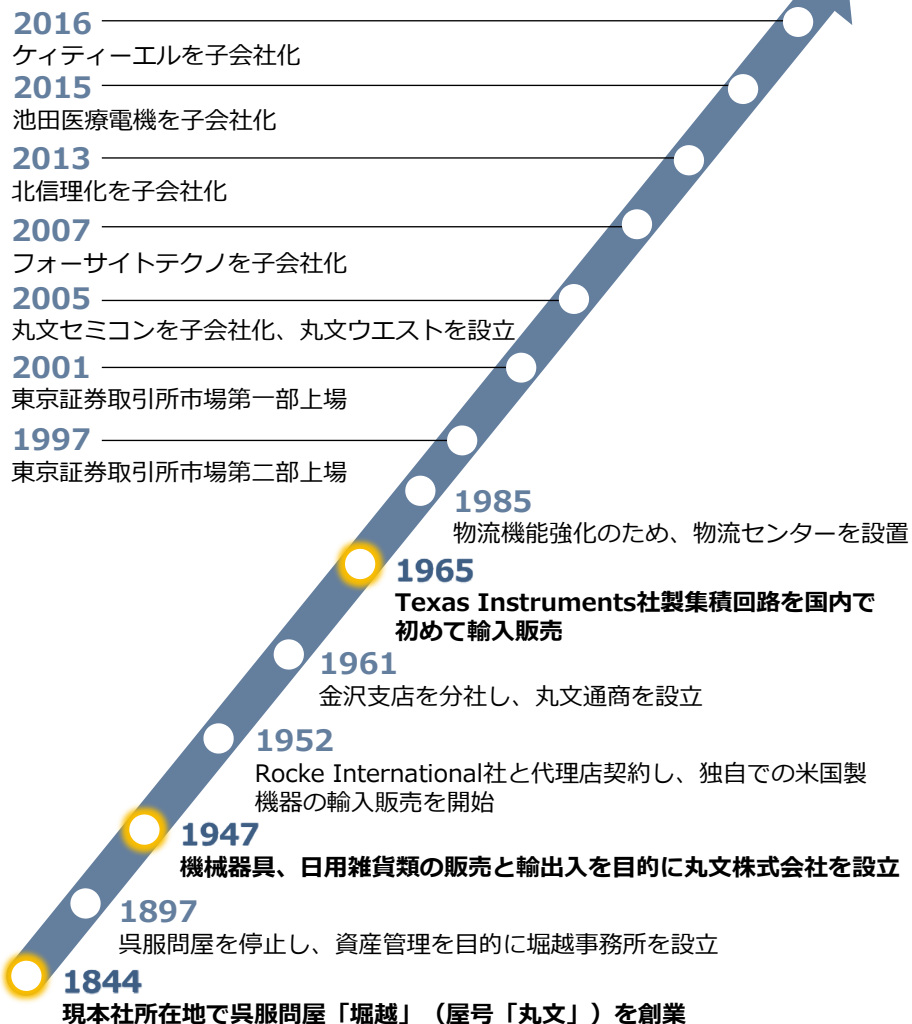
デバイス事業	システム事業
■ 半導体 ■ 電子部品	■ 航空宇宙機器 ■ 試験計測機器 ■ 科学機器 ■ レーザ機器 ■ 医用機器

連結売上高の推移

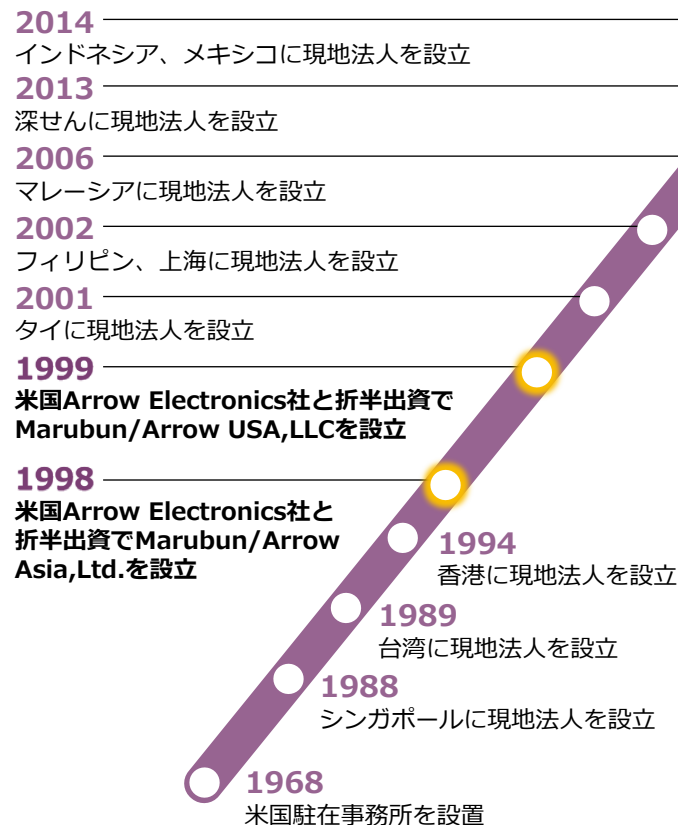


沿革

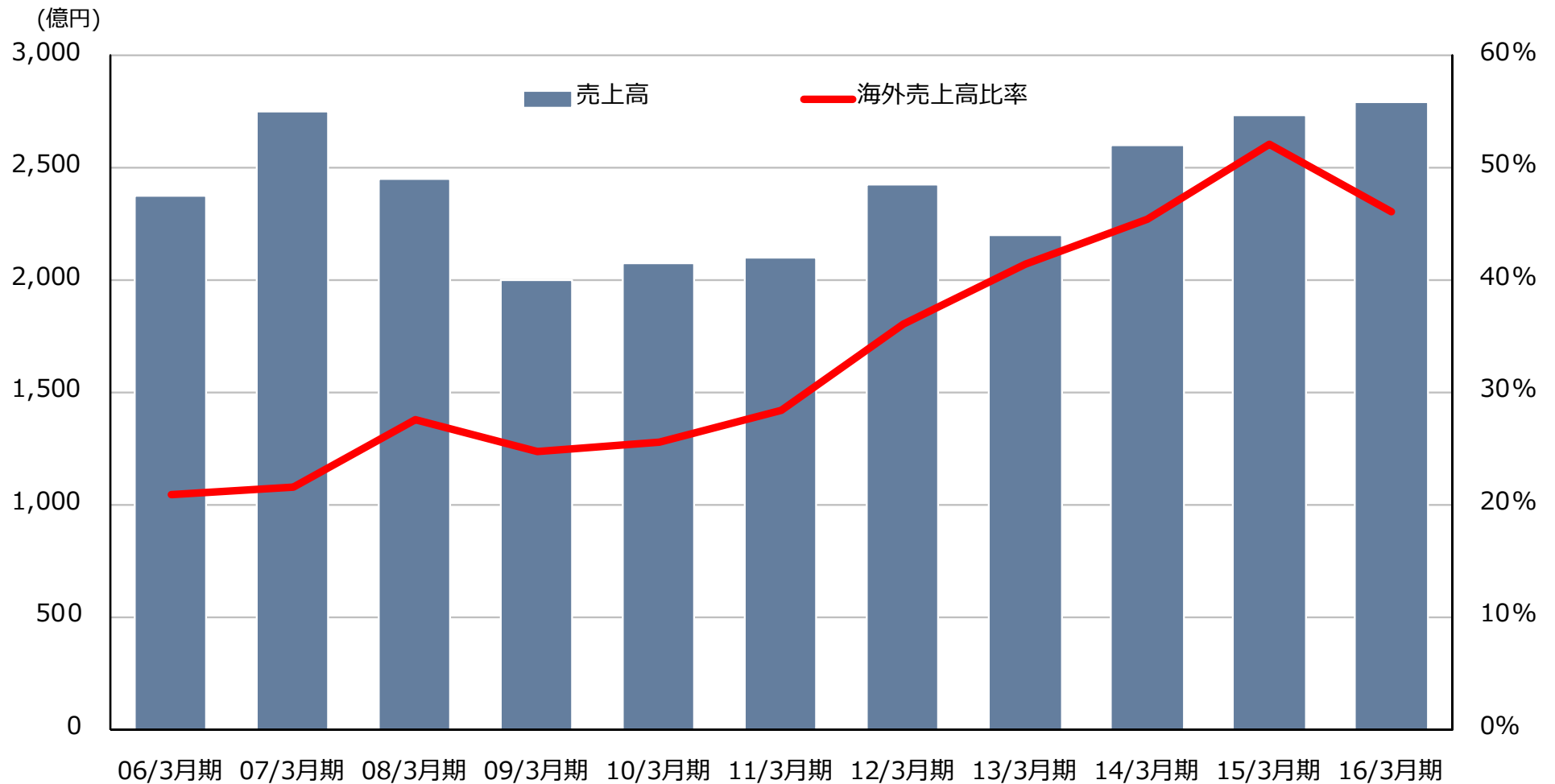
国内



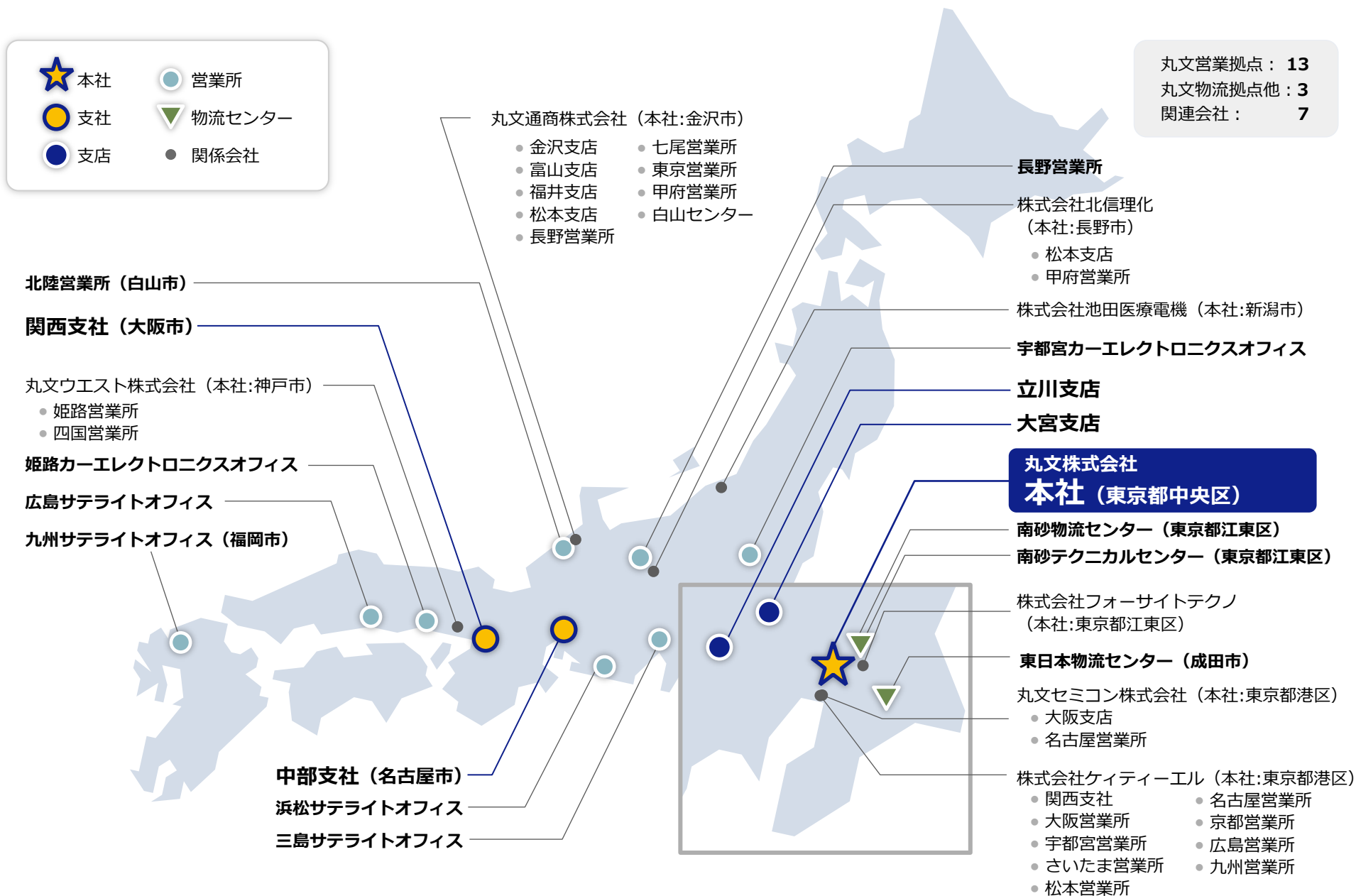
海外



中長期業績トレンド

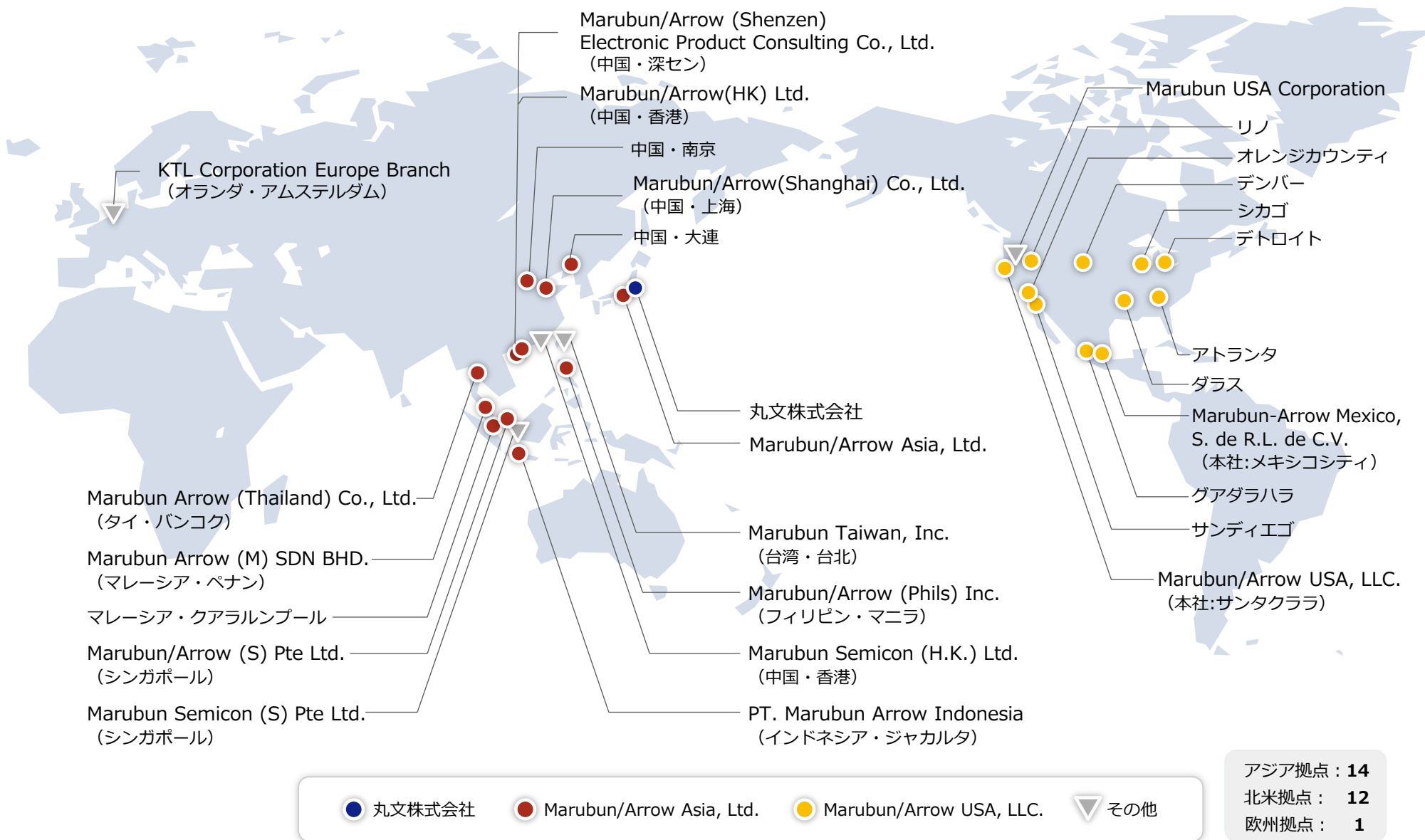


国内拠点



丸文営業拠点： 13
丸文物流拠点他： 3
関連会社： 7

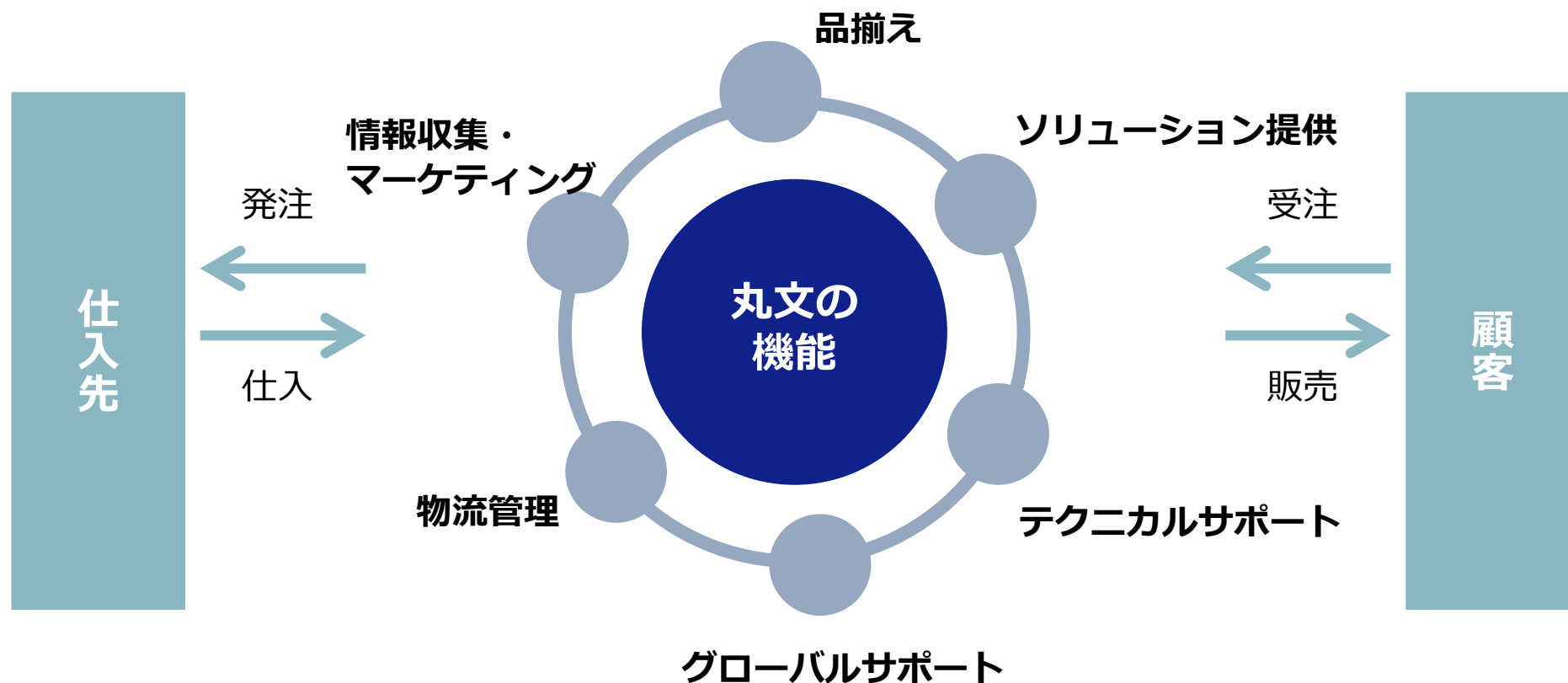
グローバルネットワーク



(2016年4月末現在)

デバイス事業：特徴と強み

- 海外サプライヤを中心とした豊富な品揃え
- 米国アロー社(85ヶ国、460拠点)との提携によるグローバルネットワーク
- 高度な技術力をもとにしたソリューション提案力
- 強固な顧客基盤



デバイス事業：グループ会社概要

社 名	住 所	設立年月	出費比率	事 業 内 容
丸文セミコン株式会社	東京都港区	2005年3月	100.0%	サムスン電子製半導体・電子部品の仕入販売
Marubun Semicon (H.K.) Ltd.	Hong Kong, China	2010年1月	100.0%	
Marubun Semicon (S) Pte. Ltd.	Alexandra Road, Singapore	2013年11月	100.0%	
Marubun USA Corporation	California, U.S.A.	1983年10月	100.0%	丸文アローUSAの持株会社
Marubun Taiwan, Inc.	Taipei, Taiwan	1989年11月	100.0%	台湾製デバイスの仕入販売
Marubun/Arrow Asia, Ltd.	British Virgin Islands	1998年10月	50.0%	丸文アローシンガポール、 丸文アロー香港の持株会社
Marubun/Arrow (S) Pte Ltd.	Anson Road, Singapore	1988年3月	50.0%	海外進出した日系企業への 半導体・電子部品の仕入販売
Marubun/Arrow (HK) Ltd.	Hong Kong, China	1994年8月	50.0%	
Marubun Arrow (Thailand) Co., Ltd.	Bangkok, Thailand	2000年10月	50.0%	
Marubun/Arrow (Phils), Inc.	Laguna, Philippines	2001年10月	50.0%	
Marubun Arrow (M) SDN BHD	Penang, Malaysia	2006年6月	50.0%	
Marubun/Arrow (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai, China	2002年9月	50.0%	
Marubun/Arrow (Shenzhen) Electronic Product Consulting Co.,Ltd.	Shenzhen, China	2013年6月	50.0%	
PT. Marubun Arrow Indonesia	Jakarta, Indonesia	2014年4月	50.0%	
Marubun/Arrow USA, LLC*	Delaware, U.S.A.	1998年11月	50.0%	
Marubun-Arrow Mexico, S. de R.L. de C.V.*	MexicoCity, MEXICO	2014年9月	50.0%	
株式会社ケイティーエル	東京都港区	1966年11月	100.0%	半導体・電子部品の仕入販売

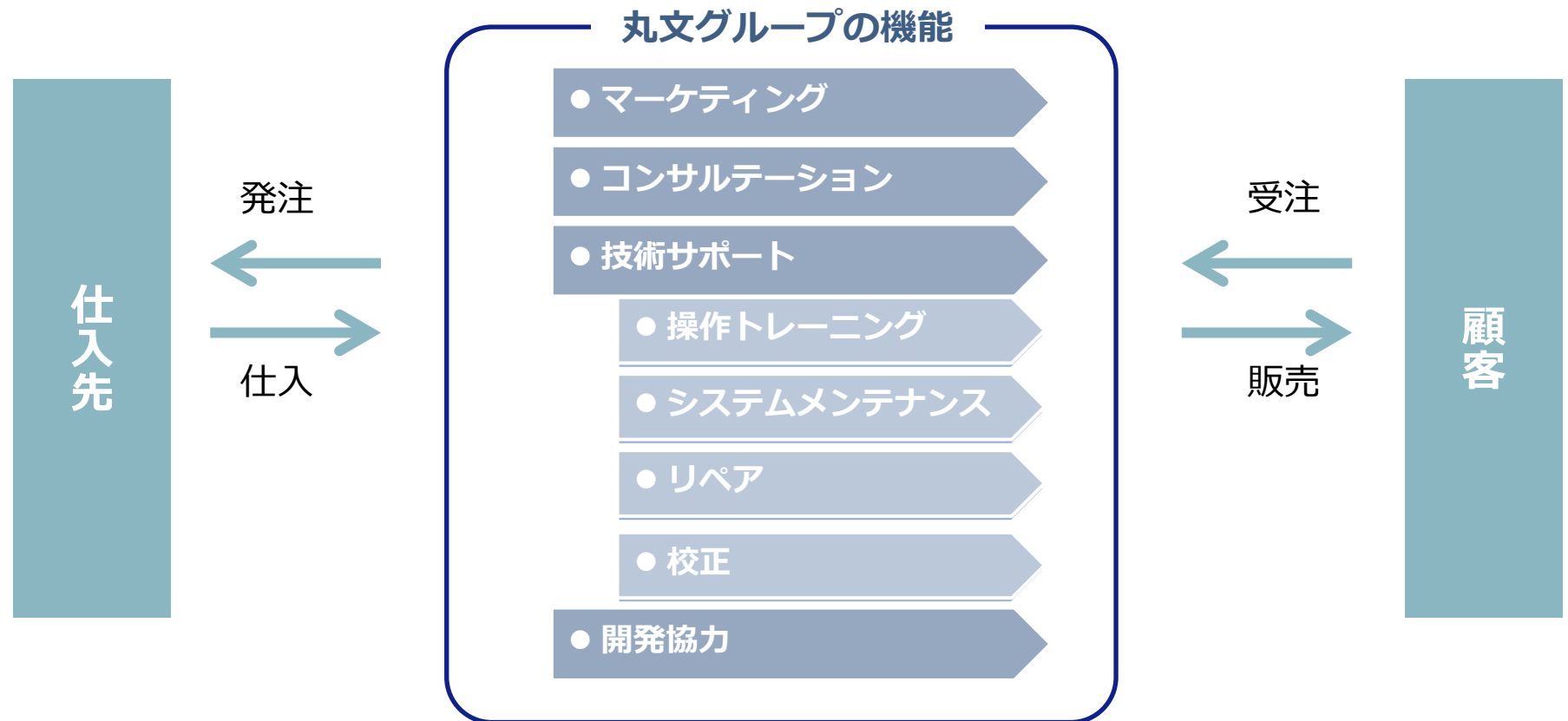
* Marubun/Arrow USA、Marubun-Arrow Mexicoは持分法適用関連会社とその子会社です。

デバイス事業：取扱製品（サプライヤ別）

			サプライヤ（アルファベット順）															
			旭化成 エレクトロニクス	Baysand (米国)	Broadcom (米国)	Eink (台湾)	FINSix (米国)	IDT (米国)	Maxim (米国)	Molex (米国)	NXP(Freescale) (米国)	Open Silicon (米国)	Qorvo (米国)	Samsung (韓国)	SanDisk (米国)	セイコー エプソン	Texes Instruments	Unimicron (台湾)
半 導 体	アナログIC		●		●				●		●		●				●	
	標準ロジックIC																●	
	メモリーIC	DRAM													●			
		フラッシュ													●	●		
		メモリーカード														●		
	マイクロ プロセッサ	MPU、MCU									●						●	
		DSP	●								●							●
	特定用途IC	ASSP	●		●				●		●		●				●	●
		ディスプレイドライバ													●		●	●
		DMD																●
LED														●				
カスタムIC		●	●								●	●		●		●		
電 子 部 品	表示デバイス					●								●				
	水晶デバイス							●								●		
	コネクタ・スイッチ・プリント基板									●								
	モジュール製品						●											

システム事業：特徴と強み

- ハイエンド市場で、技術優位性の高い電子機器・部品を提供
- システム提案から据え付け保守まで、一貫した高レベルの技術サポート



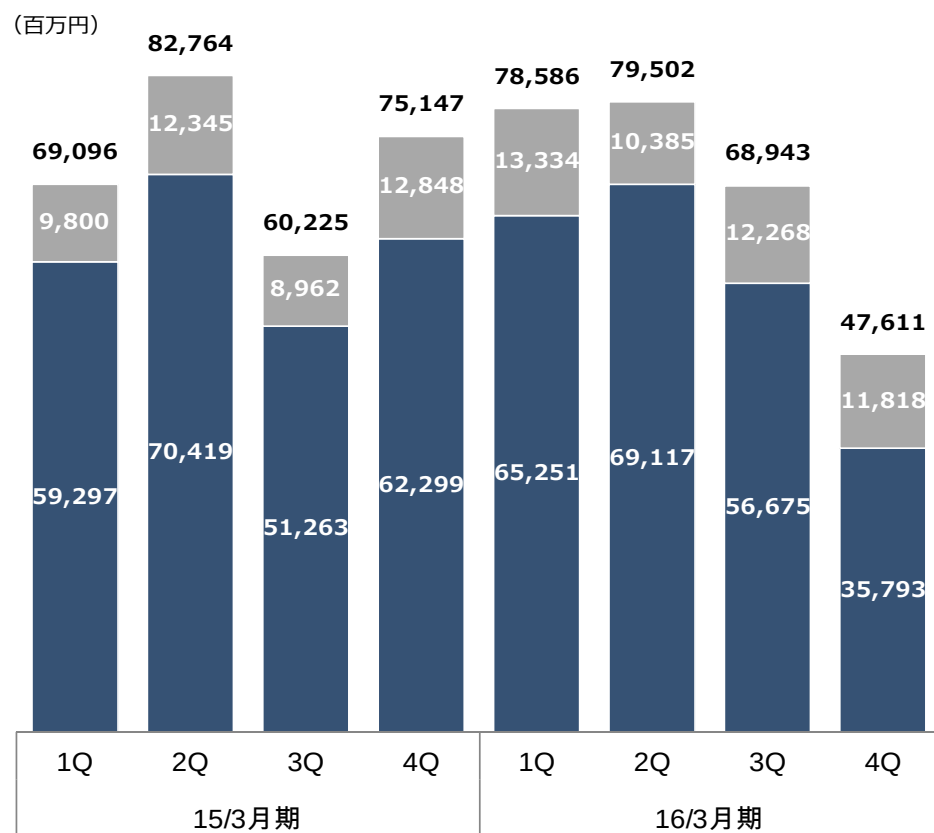
システム事業：グループ会社概要

社 名	本 社	設立年月	出費比率	事 業 内 容
丸文通商株式会社	石川県金沢市	1961年3月	100.0%	医用機器および試験計測機器の仕入販売・修理・メンテナンス
丸文ウエスト株式会社	兵庫県神戸市	2005年5月	100.0%	試験計測機器の仕入販売
株式会社北信理化	長野県長野市	1951年11月	100.0%	試験計測機器の仕入販売
株式会社池田医療電機	新潟県新潟市	1961年8月	100.0%	医用機器などの仕入販売・修理・メンテナンス
株式会社フォーサイトテクノ	東京都江東区	1999年3月	51.0%	システム製品の修理・メンテナンス、エンジニアリングサービス

業績四半期推移（事業別受注高・事業別売上高）

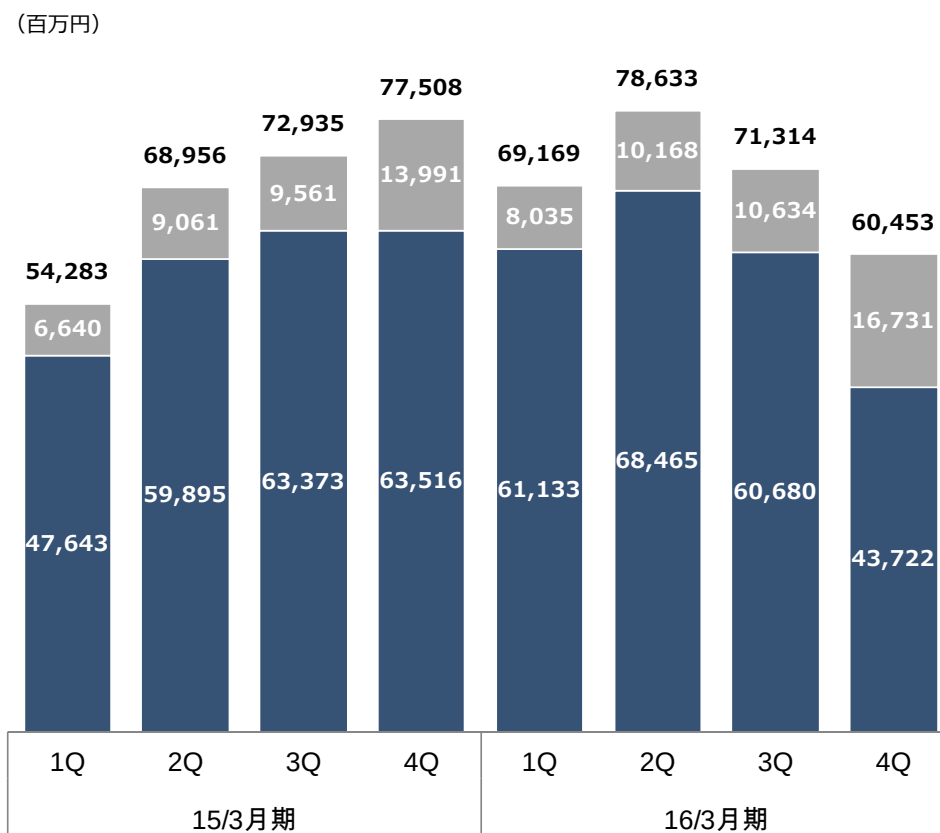
事業別受注高

■ デバイス事業 ■ システム事業

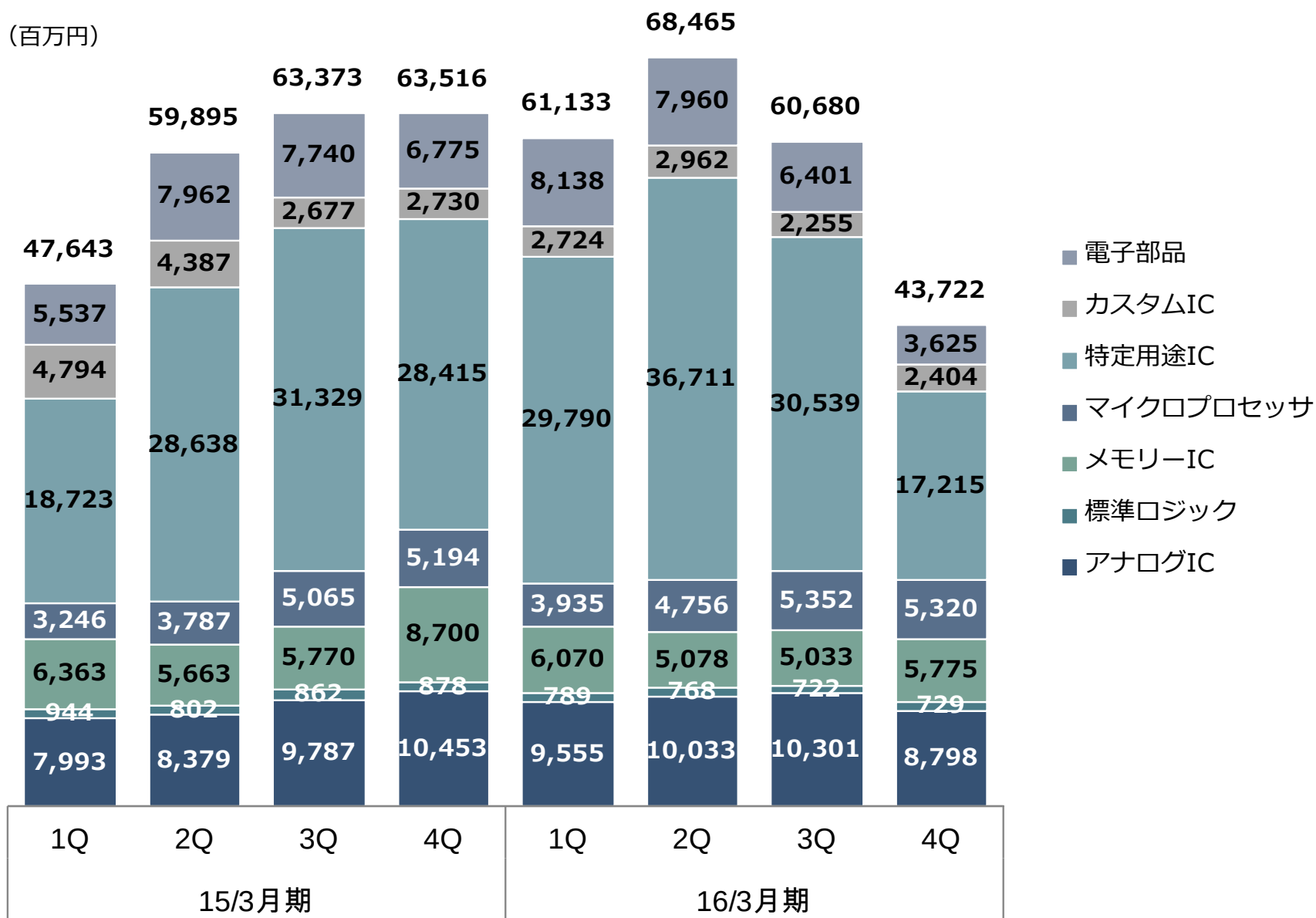


事業別売上高

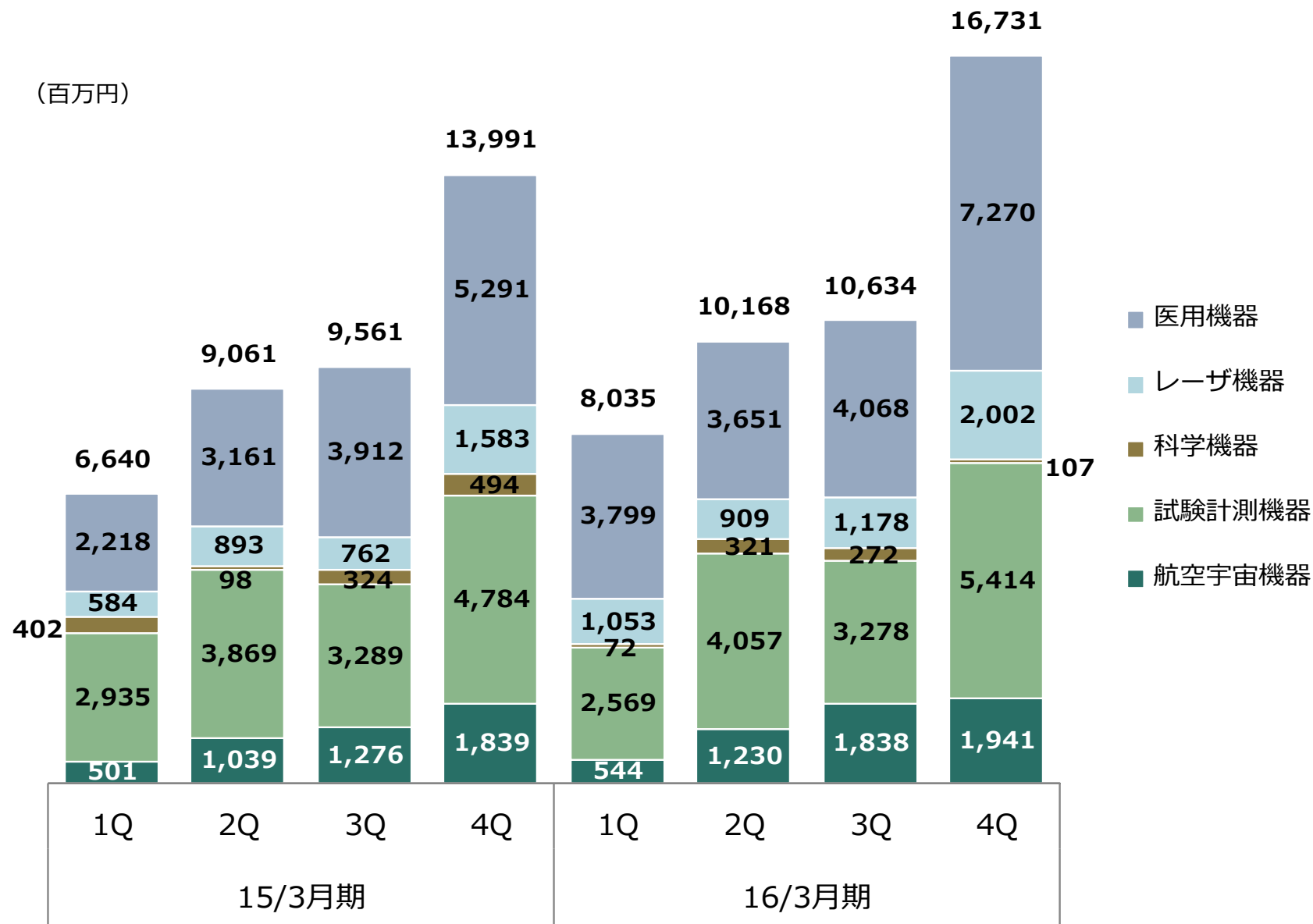
■ デバイス事業 ■ システム事業



業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）



業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）



本資料お取り扱い上のご注意

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により異なる可能性がありますことをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ

丸文株式会社 経営企画部

TEL 03-3639-3010

E-mail ir@marubun.co.jp